证券代码：605358　　证券简称：立昂微　　公告编号：2024-048

杭州立昂微电子股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：?会议召开时间：2024 年 05 月 07 日(星期二) 下午 15:00-16:30 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)?会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动?投资者可于 2024 年 04 月 25 日(星期四) 至 05 月 06 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lionking@li-on.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 07 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日 下午 15:00-16:30

(二) 会议召开地点：上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长：王敏文

董事会秘书、财务总监：吴能云

独立董事：王鸿祥

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 05 月 07 日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2024 年 04 月 25 日(星期四) 至 05 月 06 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 lionking@li-on.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券法务部

电话：0571-86597238

邮箱：lionking@li-on.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司

2024 年 4 月 23 日

公司代码：605358　　公司简称：立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除回购专户中股份数量)为基数，向全体股东每 10 股派发 0.85 元现金红利(含税)。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 676,855,027 股，扣除回购专户中股份数量 2,593,500 股，现金股利分派的股份基数为 674,261,527 股，以此计算预计派发现金红利 57,312,229.80 元(含税)。

如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上交所	立昂微	605358	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	吴能云		李志鹏	
办公地址	杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号		杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号	
电话	0571-86597238		0571-86597238	
电子信箱	ben@li-on.com		lizhipeng@li-on.com	

2 报告期公司主要业务简介

2023 年，受到全球经济持续疲软、通货膨胀高企、消费需求减弱、地缘政治危机等多重因素影响，全球半导体行业呈现波动下行的趋势。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据，2023 年全球半导体产业销售额达 5,201.26 亿美元，同比下降 9.4%。2023 年中国半导体行业同样面临行业周期下行、市场低迷、贸易环境不稳定等多重考验，2023 年国内半导体行业进出口同比下降。根据海关总署公布的 2023 年度进出口主要商品数据，2023 年全年集成电路出口 2,678.30 亿个，同比下降 1.8%；全年集成电路进口 4,796 亿个，同比下降 10.8%。

2023 年，面对市场下滑、订单不足、折旧成本高企等现实挑战，公司牢把方向、紧判大局、抓住节点、负压前行。凭借独立自主的核心技术研发体系，高效的市场快速反应能力，准确把握定制化产品与客户库存回补等订单机会，紧抓光伏、工控、汽车电子等领域中的结构性机会，在产品价格下降的大趋势下，不断加大研发投入，持续提升技术研发水平；不断加大市场开拓力度，增加市场占有率，成功开发标志性大客户，为公司实现可持续发展打下坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 268,966.99 万元，较上年同期的 291,421.63 万元下降 7.71%；实现营业利润-9,870.76 万元，较上年同期的 71,645.57 万元下降 113.78%；剔除利息、折旧摊销等因素的影响后，EBITDA(息税折旧摊销前利润)为 86,696.93 万元，较上年同期的 134,922.98 万元下降 35.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,575.25 万元，较上年同期的 68,778.99 万元下降 90.44%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,552.44 万元，较上年同期的 55,653.97 万元下降 118.96%。

影响 2023 年度公司业绩下降的主要因素有：

1、产能扩产带来的成本压力。公司部分募投项目自 2022 年 6 月开始陆续转固，相应的折旧费用、水电气等固定成本相比上年同期增加了 14,355.25 万元，叠加 2022 年下半年开始市场需求下滑，抛光片产能利用率下降，给公司带来了较大的成本压力；

2、收购嘉兴金瑞泓产生阶段性的亏损。2022 年 3 月份公司收购了嘉兴金瑞泓，2023 年仍处于产能爬坡过程中，相比上年同期亏损增加 8,073.76 万元；

3、计提的可转换债券利息费用大幅增加。公司 2022 年 11 月发行了 33.90 亿元的可转换债券，2023 年度计提利息费用 12,630.54 万元，较上年同期增加 10,976.82 万元，影响了业绩；

4、产品降价导致毛利率大幅下降。受宏观经济、市场需求方面的影响，公司主要产品售价相比 2022 年有所下滑，其中半导体硅片折合 6 英寸的平均售价下降 12.86%，半导体功率器件芯片的平均售价下降 12.33%，叠加固定成本增加和抛光片产能利用率下降的影响，导致综合毛利率由 2022 年度的 40.99% 下降至 2023 年的 19.57%，减少了 21.42 个百分点。

5、公允价值变动收益减少。2023 年度公司持有的上市公司股票股价变动产生公允价值变动收益 1,822.72 万元，与上年同期的 3,341.63 万元相比，减少 1,518.91 万元。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 102,679.73 万元，与上年同期的 119,454.25 万元相比，减少 16,774.52 万元，降幅 14.04%；投资活动产生的现金净流出 186,068.49 万元，与上年同期的 474,491.64 万元相比，减少 288,423.15 万元，降幅 60.79%，主要系上年同期支付了收购嘉兴金瑞泓的股权款及本期购买理财产品支付的现金相比上年同期大幅减少共同影响所致；筹资活动产生的现金净流出 67,526.50 万元，较上年同期减少 398,650.01 万元(上年同期为净流入 331,123.67 万元)，主要系公司上年同期发行 33.90 亿元可转换债券、本期银行借款减少及本期支付远期回购义务款项共同影响所致。

报告期末，公司总资产 1,827,599.25 万元，较期初下降 1.43%；总负债 873,025.85 万元，较期初上升 0.11%；归属于上市公司股东的净资产 797,235.30 万元，较期初下降 2.83%。

报告期内，公司开展的经营工作主要情况如下：

1、紧抓市场机遇，销量创出新高

面对半导体市场的新形势新变化，公司及时部署和动态调整硅片与芯片板块的产能匹配、产能分工，深入调研和分析市场，积极协同客户，加快产品结构调整，发挥重掺产品优势，在市场需求变化中寻求增量、多措并举抓销量。半导体硅片折合 6 英寸销量 984.36 万片（含对立昂微母公司的销量 192.50 万片），较上年同期增长 0.72%。功率器件芯片销量 171.58 万片，较上年同期增长 8.87%，创下历史新高，出现了内增 SBD 和 FRD 芯片快速上量、IGBT 芯片开始小批量出货等积极变化，实现了在清洁能源、车规、工控及消费电子领域的全覆盖，使得公司抗风险能力加大。化合物射频芯片销量 1.79 万片，较上年同期增长 141.19%，亦创下新高。

2、坚定创新战略，实现技术突破

报告期内，公司研发费用支出 27,921.11 万元，占营业收入比例为 10.38%；上年同期研发费用支出 27,182.45 万元，占营业收入比例为 9.33%。公司始终保持研发的高投入，报告期内公司研发项目主要以大尺寸半导体硅片的生产工艺技术、化合物半导体射频芯片的生产工艺技术和高端的功率器件芯片的生产工艺技术研发为主。

在半导体硅片领域，公司 12 英寸产品已覆盖 14nm 以上技术节点逻辑电路和存储电路，以及客户所需技术节点的图像传感器件和功率器件。轻掺产品不断拓展客户群体，重掺产品和技术继续保持全球领先优势。

12 英寸硅片开发了双极型-CMOS-DMOS(BCD)器件用、高压集成电路(HVIC)及电源管理集成电路(PMIC)器件用硅抛光片；动态随机存取存储器(DRAM)器件用(高带宽存储器 HBM)、闪存器件用(NOR 型和 NAND 型 Flash)硅抛光片；逻辑器件用(Logic IC)、图像传感器(CIS)器件用及 BCD 器件用硅外延片；IGBT 器件用及 Super Junction 器件用厚层硅外延片；金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET)器件用超低阻重掺磷、重掺砷衬底硅外延片；以及超平整度(Super Flat)硅抛光片等共计 11 类新产品，其中 8 类新产品已经进入批量供货，累计新产品发货量 43 万片。

开发了 BMD 增强工艺、金属吸杂工艺、轻掺单晶缺陷联合表征技术等 17 项 12 英寸新技术，大幅度改善了 Logic、CIS、BCD 等器件用硅片产品的体金属问题，解决了颗粒监控片产品经客户端重复使用后出现表面缺陷的问题，大大提升了硅片的可重复使用次数。

6-8 英寸硅片开发了低中压 MOSFET 器件用超低阻重掺磷、重掺砷衬底硅外延片、IGBT 和 FRD 器件用厚外延片，滤波器用超高阻硅抛光片等 40 余项新产品和新技术，并在主要客户量产产品上得到了全面应用，为新产品及时推出和产品性能提升提供技术保障。

在功率器件芯片领域，光伏用沟槽肖特基产品面对客户降本需求和其它 6 英寸、8 英寸晶圆厂竞争，完成了光伏用沟槽肖特基产品正向导通压降温度特性改善等新产品开发。电源用沟槽肖特基产品完成高压器件芯片原型产品工程验证。FRD 产品在重要客户量产顺利实施。在快恢复二极管产品、高压和超结 MOS 产品、IGBT 产品等方面，保证重要客户按计划推进产品开发及工程样品试制考核合格。全年共开发了 150 个新产品，转量产 75 个。

在化合物射频芯片领域，产品技术在多个创新领域有重大突破，技术水平进入全球第一梯队行列。整合并优化了化合物晶圆通用的铜柱工艺、开发了超突变结变容二极管工艺、超低噪声 0.13μm pHEMT 工艺、低缺卫星用射频芯片等新工艺和新器件。射频芯片产品开始进入低轨卫星终端客户，并实现大规模出货。开发了二维可寻址 VCSEL 工艺技术，配合客户打通瞬时功率超万瓦的 VCSEL 阵列芯片，能充分适应车载雷达的技术指标需求，将是国内首个进入量产的大功率 VCSEL 技术，成为行业内首家量产二维可寻址激光雷达 VCSEL 芯片的制造厂商。碳化硅基氮化镓芯片的开发按计划节点顺利推进。在射频和激光领域，积极推进了近 20 项新技术的开发，并及时支撑客户超过 400 套研发版的流片验证和磨合，有效支撑客户量产流片。

2023 年度公司获得授权专利 15 件(发明专利 2 件、实用新型专利 13 件)。2023 年制定硅片领域国家标准 5 项，其中主持制定 1 项，参与制定 4 项。

3、射频业务表现亮眼，成为业绩增长新引擎

公司化合物半导体射频芯片业务在 2023 年进展迅速，表现亮眼。得益于产品技术实现完全突破，客户端验证已基本覆盖国内主流手机芯片设计客户及下游手机的主要客户；得益于消费电子的复苏和进口替代加快，在手订单充裕，产能利用率回比大幅上升，产销量和营收达到历史峰值，角毛利率情况大幅改写。在市场端，在稳定核心客户的基础上开发了诸多客户，客户群体超过 160 家，并成功进入知名手机品牌公司的供应链。

4、实施大客户战略，增强市场竞争力

公司深耕行业二十多年，拥有深厚的技术积累和产业规模优势，具有独具特色的产业链一体化优势，能为客户提供从材料到芯片的一站式解决方案。

半导体硅片板块充分发挥自身在功率芯片的单晶及外延产品的技术优势，进一步拓展与中芯国际、华润微、华虹半导体、比亚迪、上海积塔、芯联集成、士兰微、青岛芯恩、粤芯半导体、力积电、日本东芝、Onsemi、Vishay 等境内外知名集成电路客户的合作；

功率器件芯片板块产品进入隆基绿能、天合光能、晶科能源、晶澳科技、通威股份、协鑫科技、阿特斯等光伏终端和宏微科技、台湾半导体、Onsemi 等客户的供应链；

化合物射频芯片板块产品进入昂瑞微、唯捷创芯、慧智微、瑞识科技、锐石创芯、华芯天微、无锡芯百特、老鹰半导体、天赛科技等知名企业的供应链。

2023 年随着公司车规产品、工控产品、微波射频产品的技术突破及快速上量，新收获了国内诸多领先的新能源汽车终端客户、手机等消费电子领域的头部终端客户。FRD 产品以一级供应商的身份进入国内某重要公司的供应链。高标准的产品质量要求和大客户行业领袖的优质属性将带动公司管理和技术的不断进步，增强公司市场竞争力。

5、建设项目有序实施，持续扩充产能规模

半导体公司的发展离不开产业规模化的投入，唯有如此，才可能实现规模效益，从而提升竞争力。

截止报告期末，半导体硅片方面，6 英寸抛光片(含衬底片)产能 60 万片/月，8 英寸抛光片(含衬底片)产能 27 万片/月、6-8 英寸(兼容)外延片产能 70 万片/月，12 英寸抛光片(含衬底片)产能 20 万片/月、12 英寸外延片产能 10 万片/月。功率器件芯片产能 23.5 万片/月，产品线包括了 6 英寸 SBD、FRD、MOSFET、TVS、IGBT。化合物射频芯片产能达到了 9 万片/年，产品线包括了 6 英寸微波射频芯片、VCSEL 芯片等。

报告期内，公司积极推进各生产基地新增产能的建设。衢州基地年产 600 万片 6-8 英寸硅抛光片项目稳步推进中，预计于 2024 年 9 月完成 25 万片/月 8 英寸新增产能设备的移机工作。衢州基地年产 180 万片 12 英寸硅外延片项目正在建设过程中。嘉兴基地 12 英寸硅抛光片扩产项目正在按计划推进中，预计 2024 年底转达到 15 万片/月的产能。海宁基地年产 36 万片 6 英寸微波射频芯片及器件生产线项目完成土建工程，开始了主要甲供设备、特气工程包、化学品工程包等招标工作，预计于 2024 年第四季度建成 6 万片/年的产能并投入商业运营。

6、积极推进产品认证，不断提高质量保证能力

在产能充裕、需求低迷、竞争激烈的市场背景下，客户对产品的质量要求越来越高，对体系建设的规范更加看重，现场审核也更趋严格。报告期内，公司各业务板块根据产线与产品实际、重点推进质量体系建设、促进体系完善与落实，确保从流程到产品的全面把控。衢州基地高压 MOSFET 用 200mm 硅外延片、200mm 重掺磷直拉硅单晶抛光片通过了品字标浙江制造认证，提高了产品的专业性和知名度。嘉兴基地 ISO9001 已获体系认证，ISO14001、IATF16949 认证也已进入最声阶段。功率器件芯片业务板块通过了一家国内某重要公司、韩国 KEC 公司的验厂审核，并进入批量供货阶段。通过了比亚迪、宏微科技等重要客户的年度审核。射频芯片业务板块通过 16949:2016、SGS ITAF 车规认证，通过小米、联想、比亚迪等 14 家客户审厂，接待 VIVO、荣耀等近十家客户验厂。

7、发挥链主优势，推动产业链上下游协同发展

金瑞泓作为集成电路材料领域的链主企业，在产业链相关领域，通过供应链合作、联合项目攻关、直接或间接股权投资等多种形式培育和发展半导体供应链企业，通过积极的横向与纵向资源整合，最大程度发挥协同效应，进一步加强与客户之间、与供应商之间的合作黏性，共同推动半导体相关产业的国产化进程。报告期内，金瑞泓筹建了浙江省半导体材料创新联合体，公司参与了产业链重要客户芯联集成电路制造股份有限公司科创板首发上市的战略配售及软件供应商上海赛美特软件科技股份有限公司的 B 轮融资。

2023 年，公司及子公司浙江金瑞泓均获国家级"专精特新"小巨人企业认定；衢州金瑞泓和金瑞泓微电子双双入选浙江省"专精特新"中小企业和衢州市工程技术研发中心；立昂东芯实施的"高线性 GaN 芯片研发"项目被列为 2024 年度浙江省尖兵计划项目；浙江金瑞泓获得宁波市首届标准创新重大贡献奖。浙江金瑞泓入选第五届（2023 年）中国电子材料行业半导体材料前十企业榜单、第五届（2023 年）中国电子材料行业综合排序前 50 企业榜单。

公司主营业务主要分三大板块，分别是半导体硅片、半导体功率器件芯片、化合物半导体射频芯片。主要产品包括 6-12 英寸半导体硅抛光片和硅外延片；6 英寸 SBD（肖特基二极管）芯片、6 英寸 FRD(快恢复二极管)芯片、6 英寸 MOSFET(金属氧化层半导体场效晶体管)芯片、6 英寸 TVS(瞬态抑制二极管）芯片及 6 英寸 IGBT（绝缘栅双极型晶体管）芯片；6 英寸砷化镓微波射频芯片、6 英寸 VCSEL(垂直共振腔表面发射激光器)芯片等三大类。三大业务板块产品应用领域广泛，包括 5G 通信、智能手机、计算机、汽车产业、光伏产业、消费电子、低轨卫星、智能电网、医疗电子、人工智能、物联网等终端应用领域。经过二十多年的发展，公司已经成长为目前国内屈指可数的从硅片到芯片的一站式制造平台，形成了以盈利的小尺寸硅片产品带动大尺寸硅片的研发和产业化，以成熟的半导体硅片业务、半导体功率器件芯片业务带动化合物半导体射频芯片产业的经营模式，很好的兼顾了企业的盈利能力及未来的发展潜力，为公司的持续、快速发展打下了坚实的基础。

1、半导体硅片业务

虽然市场下滑，但工业控制、汽车电子等细分领域持续复苏，带动所需硅片市场有所增长。在主要客户投片量缩减，公司产能利用率走低的情况下，公司及时调整销售策略，不断优化产品结构，快速准确响应客户个性化需求，重点发挥重掺产品优势，确保在客户端的市占率稳步提升。公司 12 英寸产品已覆盖 14nm 以上技术节点逻辑电路和存储电路，以及客户所需技术节点的图像传感器件和功率器件，并进一步挖掘产品类型，继续拓展新的客户群，抢占市场份额。在小尺寸上重点突破老客户的增量，保持了全年半导体硅片业务的相对稳定。

报告期内，公司半导体硅片营业收入 179,210.59 万元（含对立昂微母公司的营业收入 29,084.29 万元)，相比上年同期下降 10.94%。从销售数量来看，折合 6 英寸的销量为 984.36 万片(含对立昂微母公司的销量 192.50 万片)，较上年同期增长 0.72%，其中 12 英寸硅片销售 49.86 万片(折合 6 英寸为 199.42 万片)，较上年同期增长 35%。

公司部分募投项目自 2022 年 6 月开始陆续转产，相应的折旧费用等固定成本增加较多，但自 2022 年下半年以来，受消费电子市场需求下滑影响，硅抛光片产能利用率下降，部分硅片产品价格有所下调。由于受经济疲弱影响，衢州基地的 12 英寸硅片仍处于产能爬坡中；2022 年 3 月份收购了嘉兴金瑞泓，产能处于爬坡过程中。报告期内，受益于功率半导体需求稳定，公司硅外延片产能利用率充足。

2、半导体功率器件芯片业务

由于 2023 年全球"碳中和""碳达峰"进程的深入推进，光伏等清洁能源产业的发展十分强劲，新能源汽车等新能源交通产业的发展保持了较高的成长性，相关的半导体功率器件需求增量巨大，部分冲抵了消费电子类功率器件市场的不景气。

报告期内，公司充分发挥自身产业链一体化的优势，以不断的技术创新与稳固的技术合作充分满足客户的多样化需求，面对日趋激烈的市场竞争，进一步丰富产品系列、优化产品结构、拓展优质客户，围绕光伏与车规两大产品门类，优先扩大沟槽产品销售规模及占比，稳定提升 FRD 产品的产销占比，加快 IGBT 等产品的开发，从而确保了全年功率器件芯片业务产销量再创历史新高。其中光伏类产品高位增长，在全年全球光伏类芯片销售中占比 37%左右，车规类产品客户群继续扩大。

报告期内，公司半导体功率器件芯片营业收入 102,923.95 万元，相比上年同期下降 4.56%。从销售数量来看，销量为 171.58 万片，较上年同期增长 8.87%，其中沟槽芯片销售 89.97 万片，较上年同期增长 35%；FRD 芯片销售 9.81 万片，较上年同期增长 80.16%，IGBT 芯片开始批量供货。

3、化合物半导体射频芯片业务

受益于产品技术实现完全突破，客户验证顺利，射频芯片验证进度已基本覆盖国内主流手机芯片设计客户，国产替代加速；多规格、小批量、多用途、高附加值的特殊用途产品持续放量，低轨卫星客户已通过验证并开始大批量出货。在客户总量、订单数、产能利用率、出货量、销售额等方面均有大幅度增长，负毛利率情况大幅改写。

报告期内，公司化合物半导体射频芯片实现营业收入 13,734.95 万元，相比上年同期增长 171%。从销售数量来看，销量为 1.79 万片，较上年同期增长 141.19%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	1,827,599.25	1,854,162.38	-1.43	1,256,063.14
归属于上市公司股东的净资产	797,235.30	820,453.57	-2.83	754,242.55
营业收入	268,966.99	291,421.63	-7.71	254,091.62
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	266,785.20	287,536.70	-7.22	250,961.51
归属于上市公司股东的净利润	6,575.25	68,778.99	-90.44	60,030.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,552.44	55,653.97	-118.96	58,399.02
经营活动产生的现金流量净额	102,679.73	119,454.25	-14.04	43,752.86
加权平均净资产收益率(%)	0.82	8.91	减少 8.09 个百分点	20.09
基本每股收益(元/股)	0.10	1.02	-90.20	1.46
稀释每股收益(元/股)	0.10	1.02	-90.20	1.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	63,223.65	70,998.97	67,057.34	67,687.03
归属于上市公司股东的净利润	3,443.71	13,921.17	1,173.58	-11,963.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,349.16	2,653.36	1,069.02	-16,623.98
经营活动产生的现金流量净额	9,698.03	27,247.27	18,738.57	46,995.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

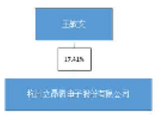
截至报告期末普通股股东总数(户)	82,639
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	78,016
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					状态	数量	
王敏文		117,831,266	17.41		质押	42,000,000	境内自然人
衢州泓祥企业管理合伙企业(有限合伙)		39,958,224	5.90		无		其他
宁波利时信息科技有限公司	-2,410,869	31,369,855	4.63		质押	31,345,000	境内非国有法人
国投创业投资管理有限公司-国投高新(深圳)创业投资基金(有限合伙)	-379,500	20,169,527	2.98		无		其他
香港中央结算有限公司	3,267,134	14,723,530	2.18		无		境外法人
衢州泓万企业管理合伙企业(有限合伙)		12,267,878	1.81		无		其他
王芯瑛		9,763,286	1.44		无		境内自然人
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	3,730,910	9,170,405	1.35		无		其他
张中锐	-196,400	8,777,671	1.30		无		境内自然人
贺银凤	-190,212	8,534,188	1.26		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人王敏文持有泓祥投资 78.50%出资份额，持有泓万投资 55.16%出资份额，为一致行动人。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 268,966.99 万元，较上年同期下降 7.71%；实现营业利润-9,870.76 万元，较上年同期下降 113.78%；剔除利息、折旧摊销等因素的影响后，EBITDA(息税折旧摊销前利润)为 86,696.93 万元，较上年同期下降 35.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,575.25 万元，较上年同期下降 90.44%，经营业绩下降的原因主要有：2023 年度受整体经济环境和半导体市场下行周期的影响，公司主要产品降价导致毛利率大幅下降；产能扩产带来的成本压力；收购嘉兴金瑞泓产生阶段性的亏损；计提的可转换债券利息费用大幅增加。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：605358　　证券简称：立昂微　　公告编号：2024- 045

债券代码：111010　　债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为更加真实、准确地反映杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称"公司")资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下：

一、资产减值准备的计提概况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关资产的减值准备。公司 2023 年对各项资产计提减值准备合计为 20,013.39 万元，具体情况如下表：

单位：万元

	2023 年度	2022 年度
信用减值损失	612.67	-22.74
其中：应收票据坏账损失	66.15	83.79
应收账款坏账损失	518.35	-105.98
其他应收款坏账损失	28.17	-0.55
资产减值损失	19,400.72	14,049.59
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失	19,400.72	14,049.59
合计	20,013.39	14,026.85

二、资产减值准备计提的具体情况说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关政策，对于应收票据、应收账款及其他应收款，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其信用损失。当单项应收票据、应收账款及其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

(二)资产减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关政策，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值，是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。当存货高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

报告期内，受国际形势和宏观经济环境等因素的影响，公司所处半导体行业景气度下滑，市场需求疲软。随着市场需求的变化，公司部分产品销售订单有所减少，部分产品价格有所下调，产能利用率下降，与此同时随着公司收购嘉兴金瑞泓及部分新建产线的完工转产，也一并增加了产品的固定成本，导致部分存货出现减值迹象。出于谨慎角度考虑，公司基于目前可获取信息，对存在减值迹象的存货计提了存货跌价准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司 2023 年度计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。没有损害公司及中小股东利益，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日

证券代码：605358　　证券简称：立昂微　　公告编号：2024-044

债券代码：111010　　债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司关于2024年度为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：浙江金瑞泓科技股份有限公司(以下简称浙江金瑞泓)、金瑞泓科技(衢州)有限公司(以下简称衢州金瑞泓)

是否为上市公司关联人：否

本年度担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司担保总额为人民币 202,851.32 万元，为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 202,851.32 万元，公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为 0，公司合计担保余额 202,851.32 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.44%。

公司不存在逾期对外担保

本次担保无反担保

一、担保情况概述

(一)为保证控股子公司生产经营、项目建设等对资金的需求，2024 年公司需要对控股子公司浙江金瑞泓、衢州金瑞泓的银行授信提供担保，本次新增拟提供的担保额度为不超过人民币 52,000.00 万元。本次担保无反担保。

(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

2024 年 4 月 22 日，公司召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
立昂微	浙江金瑞泓	88.53%	41.19	54,866.67	30,000	3.76	一年	否	否
立昂微	衢州金瑞泓	100%	36.01	14,500.00	22,000	2.76	一年	否	否

1.控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

2.上述额度为公司 2024 年度预计的新增担保额度，实际担保金额、担保期限等以签署担保协议发生的金额为准。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人浙江金瑞泓科技股份有限公司

注册地点为浙江省宁波市，法定代表人为李刚，经营范围：硅材料、化合物半导体材料、人工晶体材料及半导体器件的研发、生产；集成电路涉及；数据通讯、计算机软件技术开发；高科技项目的技术研究开发、技术咨询服务；自营和代理货物及技术的进出口。浙江金瑞泓注册资本为人民币 24,236 万元，本公司直接持有其 88.49%的股权，另通过全资子公司杭州立昂半导体技术有限公司持有其 0.04%的股权，本公司合计持有其 88.53%的股权。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江金瑞泓经审计的资产总额为 363,177.79 万元，其中流动资产 276,479.96 万元、非流动资产 86,697.83 万元，负债总额为 149,591.93 万元，其中流动负债 128,136.87 万元、非流动负债 21,455.06 万元，净资产总额为 213,585.86 万元。2023 年度，浙江金瑞泓经审计的营业收入为 155,407.89 万元，净利润为 18,789.95 万元，经营活动产生的现金流量净额为 7,346.58 万元。

(二)被担保